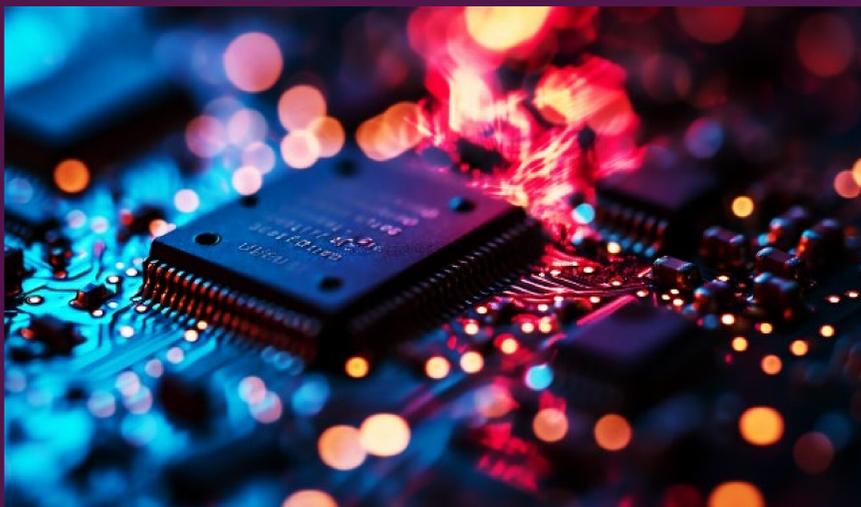


一般社団法人エレクトロニクス実装学会 関西支部

第31回若手研究会セミナー

～伝熱の基礎から半導体構造と材料の熱分析まで～



2024年7月30日(火)12:50～17:30

開催方式:現地参加&オンライン視聴
(ハイブリッド開催)

現地:大阪公立大学文化交流センター ホール
(定員150名)

<https://www.omu.ac.jp/bunkakouryu-center/>
オンライン参加(zoomウェビナー)

開催趣旨:

半導体電子機器においては発熱密度の増大にともない効果的な冷却設計を行うために、半導体、プリント配線板、セラミックス基板などの伝熱解析に必要な基礎知識が必要です。本セミナーでは伝熱の基礎知識と半導体デバイス、また高分子などの有機材料の熱分析評価の重要性、熱分析の事例などを紹介し、これらの課題をかかえた熱設計技術者のために、伝熱の基礎、熱設計法、各種材料の有効熱伝導率測定、特にセラミックス基板の熱特性測定とパワーモジュール構造における放熱性評価の国際標準化について紹介します。

講師 足利大学工学部創生工学科 教授 西剛伺氏

講演概要:伝熱解析において実用的な温度予測精度を担保するには、伝熱現象について理解するとともに、半導体、プリント配線板等の構成部品を適切にモデル化する必要がある。本発表では、これらについて解説する。

講師 JNC石油化学株式会社 未来技術研究所 藤原武氏

講演概要:高分子などの有機材料は、元々は熱伝導率が低く断熱材として使用されてきましたが、現在は多くの研究/開発により放熱材料としても広く使用されています。企業で放熱材料を開発している立場として、その熱物性や評価方法などについて説明します。

講師 産業技術総合研究所 招聘研究員 平尾喜代司氏

講演概要:高熱伝導セラミック絶縁基板の熱特性(熱伝導率、熱膨張率及び特性の温度依存性)を概説するとともに、パワーモジュール用メタライズ基板として用いた場合の放熱特性評価とその国際標準化について紹介する。

プログラム

12:50～12:55 開催の挨拶

12:55～14:20

半導体、プリント配線板の伝熱解析基礎

(西 氏)

<休憩>

14:30～15:50

高分子材料や有機無機ハイブリッド材料の熱物性とその評価

(藤原 氏)

<休憩>

16:00～17:25

セラミック基板の熱特性とモジュール構造における放熱性評価の国際標準化

(平尾 氏)

17:25～17:30 閉会

現地定員150名(先着申込順)

会員／賛助会員／協賛会員:5,000円, 学生会員:無料

若手会員／シニア会員:2,000円

非会員:10,000円, 非会員学生:1,000円

申込み方法: 下記からお願いします。(締切:7月26日迄)

会 員

賛助会員

協賛会員

非会員

申込
QRコード



* 注意事項 *

- ・各申込みサイトから、ご自身が該当する項目を選択いただき申し込みください。
- ・賛助会員用クーポン使用: クーポン番号の入力が必要です。(1人1枚利用)
- ・請求書、領収書の発行: 申込登録完了メールのマイページURL⇒ログイン⇒決済⇒出力
- ・支払方法: 振込み…手数料負担ください。カード決済…手数料なし(学会負担) クレジットカード決済がお勧めです。
- ・支払い期日: 7月31日(水)



問い合わせ先: 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

info@jiep.or.jp にご連絡ください